

## 【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成27年4月2日
【会社名】	株式会社SUMCO
【英訳名】	SUMCO CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役 橋本 眞幸
【本店の所在の場所】	東京都港区芝浦一丁目2番1号
【電話番号】	03-5444-0808
【事務連絡者氏名】	社長室経理部長 窪添 伸一
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝浦一丁目2番1号
【電話番号】	03-5444-0808
【事務連絡者氏名】	社長室経理部長 窪添 伸一
【届出の対象とした募集有価証券の種類】	株式
【届出の対象とした募集金額】	その他の者に対する割当 4,952,178,000円 (注)募集金額は、発行価額の総額であり、平成27年3月26日 (木)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
【安定操作に関する事項】	該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

## 第一部【証券情報】

### 第1【募集要項】

#### 1【新規発行株式】

種類	発行数	内容
普通株式	2,620,200株	完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。 なお、単元株式数は100株です。

(注) 1 平成27年4月2日(木)開催の取締役会においてSMB C日興証券株式会社を割当先とする第三者割当による当社普通株式2,620,200株の新規発行(以下「本第三者割当増資」といいます。)を決議しております。

2 本第三者割当増資とは別に平成27年4月2日(木)開催の取締役会において決議された公募による新株式発行の国内における一般募集(以下「国内一般募集」といいます。)を行います。

国内一般募集と同時に新日鐵住金株式会社及び三菱マテリアル株式会社を売出人(以下、本(注)2において「売出人」といいます。)とする日本国内で行われる売出し(以下「引受人の買取引受けによる国内売出し」といいます。)が行われます。

国内一般募集及び引受人の買取引受けによる国内売出しとは別に、海外市場における募集を行い、また、売出人が保有する当社普通株式の海外市場における売出しが行われます。

なお、当社は海外引受会社に対し、当社が追加的に発行する当社普通株式を取得する権利を付与します。また、海外引受会社は、売出人から当社普通株式を追加的に取得する権利を付与されます(当該各権利の割合は均等になるように行使される予定であります。)(以下、かかる追加的に発行する当社普通株式の海外市場における募集及び上記海外市場における募集を併せて、「海外募集」といいます。また、海外市場における売出し及び追加的に取得する当社普通株式の海外市場における売出しを併せて、「海外売出し」といい、海外募集と併せて、「海外募集等」といいます。なお、海外募集等は米国においては1933年米国証券法ルール144Aに基づく適格機関投資家に対する販売に限ります。)

国内一般募集及び海外募集による新株式発行の発行株式総数は33,903,800株であり、国内一般募集株数17,468,000株及び海外募集株数16,435,800株(海外募集における海外引受会社による買取引受けの対象株数14,292,000株及び海外引受会社に付与する追加的に発行する当社普通株式を取得する権利の対象株数2,143,800株)を目処に募集を行います。その最終的な内訳は、需要状況等を勘案した上で、平成27年4月20日(月)から平成27年4月23日(木)までの間のいずれかの日(以下「発行価格等決定日」といいます。)に決定します。

引受人の買取引受けによる国内売出し及び海外売出しによる売出株式総数は33,903,800株であり、引受人の買取引受けによる国内売出しの売出数17,468,000株及び海外売出数16,435,800株(海外売出しにおける海外引受会社による買取引受けの対象株数14,292,000株及び海外引受会社に付与される当社普通株式を追加的に取得する権利の対象株数2,143,800株)を目処に売出しを行います。その最終的な内訳は、需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日に決定します。

3 国内一般募集及び引受人の買取引受けによる国内売出しに伴い、その需要状況等を勘案した上で、5,240,400株を上限として、国内一般募集及び引受人の買取引受けによる国内売出しの事務主幹事会社であるSMB C日興証券株式会社が当社株主である新日鐵住金株式会社及び三菱マテリアル株式会社(以下、本(注)3において「貸株人」といいます。)より借り入れる当社普通株式の日本国内における売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」といいます。)を行う場合があります。なお、当該売出数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオーバーアロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。本第三者割当増資はオーバーアロットメントによる売出しに関連して、SMB C日興証券株式会社が貸株人から借り入れた株式(以下「借入株式」といいます。)の返還に必要な株式をSMB C日興証券株式会社に取得させるために行う第三者割当増資であり、当社は、本第三者割当増資を、国内一般募集、引受人の買取引受けによる国内売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間終了日の翌日から起算して28日目の日(28日目の日が営業日でない場合はその前営業日)の3営業日後の日を払込期日として決議しております。併せて、当社は、2,620,200株を上限として本第三者割当増資の割当てを受ける権利(以下「発行会社グリーンシューオプション」といいます。)を国内一般募集、引受人の買取引受けによる国内売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間終了日の翌日から起算して28日目の日(28日目の日が営業日でない場合はその前営業日とし、以下「グリーンシューオプション行使期限」といいます。)を行使期限としてSMB C日興証券株式会社に付与しております。なお、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、SMB C日興証券株式会社は、引受人の買取引受けによる国内売出しの対象となる株式とは別に、2,620,200株を上限として追加的に当社普通株式を取得する権利(以下「株主グリーンシューオプション」といいます。)を、グリーンシューオプション行使期限を行使期限として、貸株人から付与されます(以下、発行会社グリーンシューオプション及び株主グリーンシューオプションを併せて、「グリーンシューオプション」と総称します。)

また、S M B C日興証券株式会社は、国内一般募集、引受人の買取引受けによる国内売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間終了日の翌日から起算して28日目の日(28日目の日が営業日でない場合はその前営業日)までの間(以下「シンジケートカバー取引期間」といいます。)、借入株式の返還を目的として、株式会社東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」といいます。)を行う場合があります。S M B C日興証券株式会社がシンジケートカバー取引により取得した全ての当社普通株式は、借入株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、S M B C日興証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わない場合、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

また、S M B C日興証券株式会社は、国内一般募集、引受人の買取引受けによる国内売出し及びオーバーアロットメントによる売出しに伴って安定操作取引を行うことがあり、かかる安定操作取引により取得した当社普通株式の全部又は一部を借入株式の返還に充当する場合があります。

S M B C日興証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数から安定操作取引によって取得した当社普通株式のうち、借入株式の返還に充当する株式数及びシンジケートカバー取引により買付けた株式数を減じた株式数、すなわち、借入株式の返還に充当する不足分の株式数のみグリーンシューオプションを行使する予定であります。S M B C日興証券株式会社は、不足分の株式数の取得については、発行会社グリーンシューオプション及び株主グリーンシューオプションの割合が均等になるようにグリーンシューオプションを行使する予定であります。

そのため本第三者割当増資における発行数の全部又は一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本第三者割当増資における最終的な発行数が減少する場合、又は発行そのものが全く行われない場合があります。

S M B C日興証券株式会社がグリーンシューオプションを行使する場合には、S M B C日興証券株式会社はオーバーアロットメントによる売出しによる手取金をもとに払込みを行います。

オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われる場合の売出数については、発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場合は、S M B C日興証券株式会社による貸株人からの当社普通株式の借り入れ並びに発行会社グリーンシューオプション及び株主グリーンシューオプションの行使は行われません。また、株式会社東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行われません。

上記の取引については、S M B C日興証券株式会社は、三菱U F Jモルガン・スタンレー証券株式会社及びゴールドマン・サックス証券株式会社と協議の上、これを行うものとします。

- 4 当社は、普通株式と異なる種類の株式として、A種種類株式及びB種種類株式についての定めを定款に定めております。

普通株式の単元株式数は100株としていますが、各種類株式には議決権がないため、各種類株式の単元株式数は1株としています。また、各種類株式について、既存の株主への影響を考慮して、議決権を有しないこととしています。

- 5 振替機関の名称及び住所

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号

## 2【株式募集の方法及び条件】

## (1)【募集の方法】

区分	発行数	発行価額の総額(円)	資本組入額の総額(円)
株主割当			
その他の者に対する割当	2,620,200株	4,952,178,000	2,476,089,000
一般募集			
計(総発行株式)	2,620,200株	4,952,178,000	2,476,089,000

(注)1 前記「1 新規発行株式」(注)3に記載のとおり、本第三者割当増資はオーバーアロットメントによる売出しに関連してS M B C日興証券株式会社を割当先として行う第三者割当の方法によります。なお、当社と割当予定先との関係等は以下のとおりであります。

割当予定先の氏名又は名称		S M B C日興証券株式会社	
割当株数		2,620,200株	
払込金額		4,952,178,000円	
割当予定先の内容	所在地	東京都千代田区丸の内三丁目3番1号	
	代表者の役職氏名	取締役社長 久保 哲也	
	資本の額	100億円	
	事業の内容	金融商品取引業等	
	大株主	株式会社三井住友銀行 100%	
当社との関係	出資関係	当社が保有している割当予定先の株式の数 (平成27年2月27日現在)	
		割当予定先が保有している当社の株式の数 (平成27年2月27日現在)	119,600株
	取引関係	国内一般募集及び引受人の買取引受けによる国内売出しの事務主幹事会社	
	人的関係		
当該株券の保有に関する事項			

- 前記「1 新規発行株式」(注)3に記載のとおり、発行数が減少する場合、又は発行そのものが全く行われない場合があります。
- 発行価額の総額は、払込金額の総額であります。
- 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。また、増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とします。
- 発行価額の総額、資本組入額の総額及び払込金額は、平成27年3月26日(木)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。

## (2)【募集の条件】

発行価格 (円)	資本組入額 (円)	申込株数単位	申込期間	申込証拠金 (円)	払込期日
未定 (注)1	未定 (注)1	100株	平成27年5月27日(水) (注)2	該当事項はあ りません	平成27年5月28日(木) (注)2

(注)1 発行価格及び資本組入額については、発行価格等決定日に国内一般募集において決定される発行価額及び資本組入額とそれぞれ同一の金額とします。

2 申込期間及び払込期日については、上記のとおり内定しておりますが、発行価格等決定日において正式に決定する予定であります。なお、上記申込期間及び払込期日については、国内一般募集における申込期間の繰り上がりに応じて繰り上げることがあります。申込期間が最も繰り上がった場合は「平成27年5月22日(金)」となり、払込期日が最も繰り上がった場合は「平成27年5月25日(月)」となりますのでご注意ください。

3 全株式をSMB C日興証券株式会社に割当て、一般募集は行いません。

4 上記株式を割当てた者から申込みの行われなかった株式については失権となります。

5 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをするものとし、払込期日に後記払込取扱場所に発行価格を払い込むものとします。

## (3)【申込取扱場所】

店名	所在地
株式会社SUMCO 本店	東京都港区芝浦一丁目2番1号

## (4)【払込取扱場所】

店名	所在地
株式会社三井住友銀行 大阪本店営業部	大阪府大阪市中央区北浜四丁目6番5号

## 3【株式の引受け】

該当事項はありません。

#### 4【新規発行による手取金の使途】

##### (1)【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額(円)	発行諸費用の概算額(円)	差引手取概算額(円)
4,952,178,000	23,000,000	4,929,178,000

- (注) 1 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
- 2 前記「1 新規発行株式」(注)3に記載のとおり、発行数が減少する場合、又は発行そのものが全く行われない場合、上記金額は、変更されることとなります。
- 3 払込金額の総額(発行価額の総額)は、平成27年3月26日(木)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。

##### (2)【手取金の使途】

上記差引手取概算額上限4,929,178,000円については、本第三者割当増資と同日付をもって取締役会で決議された国内一般募集の手取概算額32,791,520,000円及び海外募集の手取概算額上限30,666,662,000円と合わせ、手取概算額合計上限68,387,360,000円について、30,000,000,000円を平成27年5月11日にA種種類株式の取得資金の一部に、26,000,000,000円を平成29年12月末日までに当社の設備投資資金に、4,000,000,000円を平成29年12月末日までに当社子会社(SUMCO TECHXIV株式会社)への投融資資金にそれぞれ充当し、残額が生じた場合には平成27年12月期中に返済期限を迎える金融機関からの有利子負債の返済資金の一部に充当する予定であります。

なお、SUMCO TECHXIV株式会社への投融資資金は、設備投資資金に充当される予定であります。

半導体デバイスの高性能化のため、シリコンウェーハメーカーに対する300mmシリコンウェーハの高精度化に係る顧客からの要求水準は、益々高まっております。前述の設備投資は、この対応を目的としたものであることから、顧客ニーズを充足させる製品展開力の維持・強化に繋がるものであります。

なお、当社グループの平成27年4月2日現在の設備投資計画の内訳は、以下のとおりとなっております。

会社名	設備の内容	投資予定額		資金調達方法	着手年月	完了予定年月	完成後の増加能力
		投資総額 (百万円)	既支払額 (百万円)				
提出会社 (株式会社SUMCO)	300mmシリコン ウェーハの高精度化 対応設備	26,000	-	増資資金、自己資金 及び借入金 (注)1	平成27年1月	平成29年12月	(注)3
SUMCO TECHXIV株式会社	300mmシリコン ウェーハの高精度化 対応設備	4,000	-	借入金 (注)2	平成27年1月	平成29年12月	(注)3
合計		30,000	-				

- (注) 1 今回調達資金にて賄える場合、自己資金及び借入金は充当しません。
- 2 今回調達資金の一部をもって当社から投融資を行います。
- 3 300mmシリコンウェーハ製造用設備の高精度化対応を目的としており、完成後においても顕著な能力増加は見込んでおりません。

#### 第2【売出要項】

該当事項はありません。

#### 第3【第三者割当の場合の特記事項】

該当事項はありません。

#### 第4【その他の記載事項】

該当事項はありません。

## 第二部【公開買付けに関する情報】

該当事項はありません。

## 第三部【参照情報】

### 第1【参照書類】

会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。

#### 1【有価証券報告書及びその添付書類】

事業年度 第16期(自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日)平成27年3月25日関東財務局長に提出

#### 2【臨時報告書】

1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(平成27年4月2日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を平成27年3月26日に関東財務局長に提出

#### 3【臨時報告書】

1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(平成27年4月2日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第1号の規定に基づく臨時報告書を平成27年4月2日に関東財務局長に提出

(注) なお、発行価格等決定日に本3の臨時報告書の訂正報告書が関東財務局長に提出されます。

## 第2【参照書類の補完情報】

上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書に記載された「対処すべき課題」、「事業等のリスク」及び「経営上の重要な契約等」について、当該有価証券報告書の提出日以後、本有価証券届出書提出日(平成27年4月2日)までの間において変更及び追加すべき事項が生じております。下記の「対処すべき課題」、「事業等のリスク」及び「経営上の重要な契約等」は当該有価証券報告書の「対処すべき課題」、「事業等のリスク」及び「経営上の重要な契約等」を一括して記載したものであり、当該変更及び追加箇所については\_\_\_\_\_ 罫で示しております。

なお、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されておりますが、下記の「対処すべき課題」、「事業等のリスク」及び「経営上の重要な契約等」に記載されたものを除き、本有価証券届出書提出日(平成27年4月2日)現在においてもその判断に変更はなく、また新たに記載すべき将来に関する事項もありません。

「対処すべき課題」

### (1) 新中期経営戦略について

#### 新中期経営戦略の背景

当社グループでは平成24年度に開始した事業再生計画に基づき、ソーラー用シリコンウェーハ事業からの撤退、半導体用シリコンウェーハ事業の生産拠点の再編と集約並びに生産体制再構築に伴う要員体制の見直し等の諸施策を着実に実施し、固定費の圧縮及び収益力の強化に努めてまいりました。また、「SUMCOビジョン」に基づき、製品の差別化のための技術開発とコスト削減を行い、市場環境の急変に対応できる体質変革を行ってまいりました。その結果、直近3決算期においては連結当期純利益の黒字を達成しており、当社グループは業界内でも高い技術力と収益性を持つポジションを獲得するに至ったものと認識しております。

他方、当社グループを取り巻く市場環境については、多様なアプリケーションに牽引され、半導体デバイス市場は堅調に成長を続けており、それに伴いウェーハ市場も力強く成長するとともに、高精度品を中心に需給タイト化に伴う価格改善に向けた環境が整いつつあると認識しております。かかる状況を踏まえて、当社グループは、新たな成長ステージの指針となる新中期経営戦略を策定いたしました。

#### 新中期経営戦略について

##### ア) 事業 / 投資戦略

特に重要となる設備投資戦略について、まず、第一フェーズとして、足元の需給環境及び当社グループの高い技術力を背景に、本格的な価格改善・価格正常化の実現を目指すとともに、300mm向け次世代高精度対応・開発装置の導入等、高精度品対応のための適切な設備投資を実施し、更なる競争力の強化による利益率向上を目指します。

次に、第二フェーズとして、あくまで十分な価格改善・価格正常化を前提に、適切な需給バランスの維持に最大限配慮しながら、時機を捉えた規律ある設備投資を実施いたします。また、機動的な設備投資の対応を目指し、価格改善後は、徐々に投資効率の高いボトルネック解消投資を進めて参ります。更に顧客からのニーズに応じ、かつ十分な投資対効果が期待できる場合は増産投資も検討いたします。それにより、品質・数量ともに顧客の意向に沿った生産・納入を果たすことで顧客との関係をより強固なものにし、収益力・シェアとともに一段と強固なポジションを確立することで、更なる利益成長を目指します。

##### イ) 財務戦略

前述の事業 / 投資戦略を支えるために、資本増強・資本再構築プラン(その詳細は後記「(2) 資本増強・資本再構築プランについて」)をご参照ください。)を実行し、規律ある成長投資及び柔軟な株主還元が実施可能な財務体質を構築することにより、今後は利益の積上げを基に更に財務健全性の強化を図る所存です。

##### ウ) 財務目標

当社グループは、持続可能な利益成長を念頭に、業況悪化時においても利益確保、好況期においては直近期の実績を大きく上回るROEの実現を目指します。また、シリコンウェーハ事業の高いボラティリティも踏まえ財務健全性を更に高め、自己資本比率で50%以上、D/Eレシオで0.5倍以下の財務体質確保を目標にするとともに、今後の利益状況に応じ、柔軟かつ積極的な株主還元の実施を目指します。



## (2) 資本増強・資本再構築プランについて

## 資本増強・資本再構築プランの背景及び目的

「(1) 新中期経営戦略の背景」に記載のとおり、当社グループは、事業再生計画に織込んだ諸施策を確実に実行し、平成26年12月期においては連結営業利益率11%を超える業界内でも高い収益性の確立を実現したと自負しておりますが、半導体用シリコンウェーハ需要が事業再生計画策定時の想定よりも弱かったことから、財務体質は想定どおりの改善までには至りませんでした。一方、事業再生計画策定時に発行したA種種類株式については、金銭及びB種種類株式を対価とする取得請求権の行使可能期間が本年5月から開始されるため、今後随時種類株主が取得請求権を行使し、資本及び現預金が減少することが見込まれております。このような現状を踏まえ、前述のとおり好調な事業環境において当社グループの成長機会の広がりを認識する中、「(1) 新中期経営戦略について」に記載の事業/投資戦略の実行を支えるため、優先配当負担があり、かつ今後随時取得請求を受けるであろう種類株式から安定的な資本である普通株式に入れ替えるとともに更なる資本増強を図ることで、財務基盤を強化し規律ある成長投資が実施可能な体制を整え、柔軟な株主還元を実現する基盤を構築することが、当社グループの中長期的な利益成長の礎となり、ひいては当社普通株式の株式価値向上に資するものと判断いたしました。

## 資本増強・資本再構築プランの内容

当社は、資本増強・資本再構築プラン(以下「本プラン」といいます。)を実施するため、A種種類株主3者との間で、平成27年3月3日付で種類株式の処理に関する覚書(以下「本覚書」といいます。)を締結いたしました。本覚書に従い、当社は、A種種類株式の処理並びにA種種類株主3者による金銭及びB種種類株式を対価とするA種種類株式に係る取得請求権の行使に伴いA種種類株主3者に交付するB種種類株式の処理に向けた手続を行う予定です。本プラン及び本覚書の主な内容は以下のとおりです。

## ア) 普通株式の希薄化の回避

普通株式の希薄化を回避するため、当社は、下記イ)及びウ)記載の手続に従いA種種類株式及びB種種類株式の全てを取得する予定であり、A種種類株式及びB種種類株式にそれぞれ付された普通株式を対価とする取得請求権は、A種種類株主3者により行使されません。これにより、当社が平成24年5月11日に発行しましたA種種類株式は、普通株式に転換されることなく、下記イ)及びウ)記載の手続に従い、金銭を最終的な対価としてその全数を取得し、その後速やかに消却することになります。

## イ) A種種類株式の取得

## (ア) 金銭及びB種種類株式を対価とする取得請求権の行使

A種種類株主3者は、当社の既存の分配可能額の範囲内で、平成27年5月11日に、その保有するA種種類株式各150株(合計450株)のうち各50株(合計150株)について、金銭(1株につき1億円及び定款所定の経過A種配当金相当額)及びB種種類株式(A種種類株式1株につき、1株)を対価とする取得請求権を行使します(以下「本行使」といいます。)

## (イ) 金銭及びB種種類株式を対価とする取得請求権の行使

当社は、平成27年4月2日開催の取締役会において、当社普通株式の公募増資(以下「本公募増資」といいます。)を行うことを決議しました。

本公募増資の払込みが完了した場合には、当社は、本公募増資の払込期日と同日付にて、発行登録書に記載の発行予定額(600億円)を上限として、本公募増資により増加する資本金及び資本準備金の額を減少させ、その他資本剰余金に振り替えます(かかる資本金及び資本準備金の額の減少を以下「本減資・減準備金」といいます。)

当社が本減資・減準備金を完了した場合、これにより増加するその他資本剰余金により、当社は、A種種類株式の取得請求に備え、分配可能額を確保します。A種種類株主3者は、本減資・減準備金の効力発生日又は平成27年5月11日のいずれか遅い日に、その保有する全てのA種種類株式(本行使に係るA種種類株式150株を除いた残りの300株)について、金銭(1株につき1億円及び定款所定の経過A種配当金相当額)及びB種種類株式(A種種類株式1株につき、1株)を対価とする取得請求権を行使します(以下「本行使」といいます。)

## ウ) B種種類株式の取得

## (ア) 資本準備金の額の減少

当社は、本行使 及び本行使 に際して交付されるB種種類株式について、B種種類株式の当社普通株式を対価とする取得請求権が行使された場合に発生する当社普通株式の希薄化を回避する目的で、法令上必要となる手続を経て、下記(イ)及び(ウ)に記載の内容で、その全てを会社法上の自己株式取得の方法により取得する方針です。

また当社は、かかる当社普通株式の希薄化を回避するためのB種種類株式の取得に充てる分配可能額を確保することを目的として、平成27年4月14日を効力発生日として、90億円の資本準備金の額の減少を行い、同額をその他資本剰余金に振り替えることといたしたいと存じます。

## (イ) 本行使 に係るB種種類株式の取得

当社は、B種種類株式150株を、本行使 が行われる日である平成27年5月11日に、総額30億円(1株につき2,000万円)を対価として取得する予定です(以下「本自己株式取得」といいます。)。これにより、本行使 によりA種種類株主に交付されるB種種類株式150株は、同日付で、全て当社により取得されることとなり、当該B種種類株式の当社普通株式を対価とする取得請求権が行使されることはありません。

## (ウ) 本行使 に係るB種種類株式の取得

当社は、B種種類株式300株を、本行使 がなされた日に、総額60億円(1株につき2,000万円)を対価として取得する予定です(以下「本自己株式取得」といいます。)。これにより、本行使 によりA種種類株主に交付されるB種種類株式300株は、同日付で、全て当社により取得されることとなり、当該B種種類株式の当社普通株式を対価とする取得請求権が行使されることはありません。

## (エ) B種種類株式の取得に係る取締役会決議

当社は、平成27年4月2日開催の取締役会において、本プランに従い、A種種類株式の金銭及びB種種類株式を対価とする取得請求権が行使された場合にA種種類株主に交付されるB種種類株式について、B種種類株式の当社普通株式を対価とする取得請求権が行使された場合に発生する当社普通株式の希薄化を回避するため、以下のとおり、会社法第157条の規定に基づく自己株式(B種種類株式)の取得を決議いたしました。

## a) 取得する株式の種類

B種種類株式

## b) 取得する株式の総数

本自己株式取得 については150株を上限とし、本自己株式取得 については300株を上限とする。

## c) 株式1株当たりの取得金額

金2,000万円

## d) 株式の取得価額の総額

本自己株式取得 については金30億円を上限とし、本自己株式取得 については金60億円を上限とする。

## e) 株式の取得予定日

本自己株式取得 については平成27年5月11日とし、本自己株式取得 については本減資・減準備金の効力発生日又は平成27年5月11日のいずれか遅い日とする。

## f) 取得の条件

上記e)の取得予定日において、当該取得に係る取得する株式の数以上の数のB種種類株式が発行されていること

## エ) 本自己株式取得 又は本自己株式取得 が予定通りに完了しない場合の対応

本覚書締結後、( )各A種種類株主3者による本行使 が行われたにも拘わらず、当該各A種種類株主3者について本自己株式取得 が平成27年5月11日に完了しない場合又は( )各A種種類株主3者による本行使 が行われたにも拘わらず、当該各A種種類株主3者について本自己株式取得 が本行使 の効力発生日に完了しない場合、若しくは本自己株式取得 が平成28年3月10日までに完了しない場合(但し、本減資・減準備金の効力発生日が平成27年5月11日以前の場合には、本自己株式取得 が平成27年5月11日までに完了しない場合)、当該各A種種類株主3者との本覚書の当事者との関係において、本覚書は、同日の経過をもって効力を失います。但し、当社及びA種種類株主3者は、他の本覚書の当事者より種類株式の発行会社による取得及び種類株主による取得請求権の行使の時期の調整を含む本覚書の変更に関する申し出があった場合には、かかる本覚書の変更について合意を形成するよう誠実に協議します。かかる協議に際し、当社及びA種種類株主3者は、既存株主の皆様の希薄化に対する懸念に配慮する方針をもって協議を進めるものとします。

## オ) 取得したA種種類株式及びB種種類株式の消却

本行使 及び本行使 により取得したA種種類株式並びに本自己株式取得 及び本自己株式取得 により取得したB種種類株式は、その後、速やかに消却することを予定しています。

### (3) 原材料在庫について

シリコンウェーハの主要原材料である多結晶シリコンにつきましては、長期購入契約締結時の需要予測と足元の消費見通しに乖離が生じていることにより、現在余剰在庫を保有しており、原材料在庫を含む「原材料及び貯蔵品」の残高は、対前年度末比、63億円増加の1,220億円となっております。

「原材料及び貯蔵品」の残高は、平成27年12月期期末には、おおよそ1,300億円強まで増加する見込みであります。今後、徐々に長期購入契約の契約期間満了を迎えることから、毎年の増加額は漸減傾向にあり、平成28年度頃にピークを迎えた後、減少に転ずる見通しであります。

中長期的には適正水準に回復する見込みではありますが、今後も原材料在庫の適正水準への早期回復に向けて、努力してまいります。

### 「事業等のリスク」

当社グループは、以下のような事項を当社グループの経営並びに事業遂行上の主要なリスク要因と認識しており、その発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針であります。これらの要因により、当社グループの事業、経営成績等に重要な影響を及ぼす可能性があります。

なお、以下の事項のうち将来に関する事項は、提出日現在において当社グループが判断したものであり、不確実性を内在しているため、実際の結果と異なる可能性があります。

#### (1) 事業環境について

当社グループが製造及び販売するシリコンウェーハは、パソコン、スマートフォン、タブレット型端末といった携帯端末、自動車、及びその他民生品を含む各種製品に使用される半導体基板等に用いられることから、半導体やその周辺産業に特徴的な諸要因の影響を受けることがあります。かかる諸要因には、急激な市況悪化、急速な技術革新の進展、製品の陳腐化、製品構成の急速な変化、製品価格の下落、特定顧客との取引の集中とその特定顧客からの受注の大幅な変動、同業他社との競争優位性の変化に伴う当社グループの競争力の変動、及び顧客需要の大きな振幅等があり、これらは当社グループの経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

また、主な取引先のある国を含む各国の政治情勢やエネルギーを始めとする資源価格及び電力価格の変動等といった国内外の経済情勢が、当社グループの経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

#### (2) 当社グループの製品について

当社グループの製品が用いられる半導体の価格は、製品の市場投入後は普及による販売数量拡大等の影響もあり、一般的に低下する傾向にあります。当社グループにおいては、量産化による販売数量の拡大や製造工程等における歩留率向上等の合理化を進めることにより、当該製品価格低下を想定した事業計画を策定しておりますが、急激な需給バランスの悪化、その他の事由により想定以上の販売価格低下が生じる場合、当社グループの経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

なお、上記以外にも、品質の不適合（具体的には、当社グループが顧客に納入した製品について、顧客の要求規格及び仕様等を充足しない場合、または不適合等が生じる場合に重大な品質クレームを引き起こす可能性）、生産性向上の未達成等（具体的には、製品製造工程における歩留率改善等による継続した生産効率の向上が図られない場合の利益の圧迫要因、もしくは製造設備の事故やシステム障害、その他の要因による製造の中断、あるいは大幅な遅延等が生じる場合に、当社グループ全体の生産能力低下や特定製品の供給が困難となる可能性等）が当社グループの経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

#### (3) 原材料の調達について

シリコンウェーハの主要原材料は、極めて純度の高い多結晶シリコンであり、製造者が限定されていることから、供給不安のリスクがあります。そのため、当社グループは、世界の主要な多結晶シリコンメーカーとの間で、多結晶シリコンメーカーが一定期間に一定の数量を供給し、当社グループが購入する旨の長期購入契約を締結し、原材料の安定調達を図ってまいりましたが、長期購入契約締結時の需要予想と足元の消費見通しに乖離が生じていることから在庫が増加しております。

また、長期購入契約においては、契約期間中の購入価格水準が決められていることから、これらが終了し在庫水準が適正な水準に回復するまでの間は原材料コスト低減の機会が制約される可能性があります。

原材料在庫を含む「原材料及び貯蔵品」の増加見通しについては、「対処すべき課題」に記載したとおりですが、事業環境の著しい変化等により、消費量が変動した場合、あるいは、会計上の対応が必要となる場合、当社グループの経営成績、財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。

- (4) 主要製造設備の安定調達について  
当社の主要製造設備には、当社と設備機器メーカーとの間で共同開発した両面研磨機等、他メーカーへの切り替えができない設備があります。これらの円滑な調達が困難な場合には、経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。
- (5) 顧客及びサプライヤーに係るリスク(経営破綻・操業停止等)について  
当社グループは、顧客の与信管理には万全を期しておりますが、仮に顧客が倒産し、多額の売上債権が回収不能となる場合、当社グループの経営成績、財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。また、当社は諸資材の調達については、複数のメーカーと契約する等、調達途絶リスクを回避する施策を講じておりますが、経済環境の急激な悪化やサプライヤーの設備事故等による操業停止あるいは倒産等により、諸資材等の調達に支障を来たす場合、当社グループの経営成績、財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
- (6) 設備投資について  
当社グループは中長期的な需要予測に基づいて設備投資を実施しておりますが、経済動向や半導体業界を取り巻く環境の変化により、需要予測に大幅な変化が生じる場合には、当社グループの事業展開、経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。
- (7) 資金調達について  
当社グループのシンジケート・ローン契約等につきましては、財政状況の著しい悪化により、その財務制限条項に抵触し、当該借入金について返還請求を受け期限の利益を失った場合には、当社グループの資金調達に影響を及ぼす可能性があります。  
また、金利水準や市場環境等の要因により当社グループが希望する時期または条件により資金調達が実行できない場合には、当社グループの経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。
- (8) 技術及び研究開発について  
半導体業界は、急速な技術革新が進む業界であり、半導体の高集積化、細密化や半導体用途の多様化、高精度化及び生産効率の向上等、当社グループのシリコンウェーハに対して顧客より要求される各種技術は多岐に亘り、かつ、高度化しております。当社グループは、かかる顧客からの要求に応えるため、中長期的に需要の拡大が見込まれる300mmウェーハに関する技術、品種別ではエピタキシャルウェーハやアニールウェーハ等の高付加価値ウェーハ関連技術、さらに、次世代ウェーハ製品の関連技術等に重点をおいた研究開発活動を行っております。  
しかしながら、業界における技術進歩への対応に支障が生じ、顧客の要求に適合することが困難となり、研究開発活動が想定した効果を得られない場合や、他社に比べ技術開発が遅れた場合には、当社グループの事業展開、経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。
- (9) 知的財産権について  
当社グループは、シリコンウェーハ業界において競合他社に対抗していくためには、特許権その他の知的財産権の確保が非常に重要であると認識しており、国内外において出願中のものを含めて多数の特許を保有しております。  
また、当社グループは、大重量結晶の製造、無欠陥結晶、高精度の両面研磨技術等に関する基本特許を保持しておりますが、さらに、これら特許から発展した技術及び周辺技術についても特許の出願を進めております。  
しかしながら、当社グループが認識しない第三者の特許が既に成立している場合において、当該第三者より知的財産権を侵害しているとの事由により、使用差止及び損害賠償等の訴えを起こされる場合、当社グループの事業展開、経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。
- (10) 海外展開について  
当社グループは、全世界の主要な半導体メーカー等に対してシリコンウェーハを供給しておりますが、生産・販売活動については、日本国内に加えて、北米、欧州及びアジアにそれぞれ拠点を設置し事業を展開しております。当社グループのこれらの生産・販売活動には、為替変動リスクがあるほか、各国及び各地域等の経済情勢、政治情勢、法規制、税制、為替規制等の変化による影響や、現地での紛争、テロや災害の発生、感染症の流行、社会・労働慣行の相違、社会的インフラの未整備等による影響を受ける可能性があります。

(11) 環境規制等について

当社グループの事業は、主に製造拠点において、エネルギーの使用、排気、排水、有害化学物質の使用及び保管、産業廃棄物の廃棄、土壌及び地下水の汚染の検査及び浄化等、環境に関する多くの国内外の法的規制を受けており、これらの規制に基づき一定の費用負担や賠償義務その他法的責任が生じる可能性があります。また、近年においては、一般的にこれら環境等に関する規制は強化される傾向にあります。今後において環境等に関する新たな国内外の法規制等が制定される可能性は否定できず、そのような場合、当社グループにおいて、これら法規制等への対応のために新たな費用負担等が生じることが予想され、当社グループの事業展開、経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

(12) 自然災害、事故等のリスクについて

当社グループの各製造拠点において、台風、豪雨、地震、津波または火山活動等の自然災害や、事故、火災、テロ等により、生産の停止、設備の損壊や給水・電力供給の制限等の不測の事態が発生する場合には、当社グループの事業展開、経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

特に、当社グループの主力商品である300mmウェーハの加工工程を有する製造拠点が、上記の自然災害、事故、火災等に見舞われる場合、300mmウェーハの製造・販売に支障を来し、当社グループの事業展開、経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

(13) 企業買収に関するリスクについて

当社は、企業買収の実施にあたり、当該企業の財務内容等についてデューデリジェンスを行い、事前にリスク回避するように努めておりますが、事業環境の急激な変化等、不測の事態が生じる場合、当社グループの事業展開、経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

(14) 上記以外のリスクについて

当社グループは、事業環境の変化等により、以下のような事態が生じる場合、当社グループの経営成績、財政状態等に影響を及ぼすことがあります。

事業環境の大幅な変化により事業及び組織の再構築等が必要となる事態が生じる場合。

退職給付債務に関して、今後当社の年金資産の時価の下落、運用利回りの低下、または退職給付債務を計算する数理計算上の前提条件の大幅な変化が生じる場合。

経済環境の変化等により、収益が悪化し、または将来の収益の見積りが大幅に変動する等により、会計上の対応が必要となる場合。

当社グループの事業に必要な人材を確保できない場合。

当社グループの製品の不具合等に起因する争訟やその他の争訟が生じた場合。

内部統制が有効に機能しない事態が生じる場合。

「経営上の重要な契約等」

(1) 当社は、住友金属工業株式会社(現 新日鐵住金株式会社)、三菱マテリアル株式会社及びジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第壹号投資事業有限責任組合に対して第三者割当によるA種種類株式を発行すること、及び割当先がA種種類株式を引受けることに関する引受契約を、平成24年3月8日付で、割当先3社との間で締結いたしました。当該A種種類株式発行による資金調達額は450億円であり、平成24年5月11日に払込手続が完了しております。なお、当該A種種類株式の内容は、「第4 提出会社の状況」の「1. 株式等の状況」のうち、「(1) 株式の総数等」の「発行済株式」に記載のとおりであります。また、当社は、種類株式の処理に関する覚書を、平成27年3月3日付で、上記割当先3社との間で締結いたしました。当該種類株式の処理に関する覚書の概要は、上記「対処すべき課題」のうち「(2) 資本増強・資本再構築プランについて」に記載のとおりであります。

(2) 当社グループは、シリコンウェーハの主要原材料である多結晶シリコンを世界の主要な多結晶シリコンメーカーから調達しておりますが、その一部において、多結晶シリコンメーカーが一定期間に一定の数量を供給し、当社グループが購入する旨の長期購入契約を締結しております。

(3) SUMCO TECHXIV株式会社は、FORMOSA SUMCO TECHNOLOGY CORPORATIONを合併会社として運営する旨の契約を、平成7年8月4日付で、FORMOSA PLASTICS CORPORATION及びASIA PACIFIC INVESTMENT CO.との間で締結しております。なお、FORMOSA SUMCO TECHNOLOGY CORPORATIONに対する出資比率は以下のとおりであります。

SUMCO TECHXIV株式会社	49%
FORMOSA PLASTICS CORPORATION	29%
ASIA PACIFIC INVESTMENT CO.	17%
その他	5%

### 第3【参照書類を縦覧に供している場所】

株式会社SUMCO 本店  
(東京都港区芝浦一丁目2番1号)  
株式会社東京証券取引所  
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

### 第四部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

### 第五部【特別情報】

該当事項はありません。